

PRECISION ACCRETECH BLADE  
RESIN BOND BLADES  
封装材料用树脂刀片 PG 系列

 **ACCRETECH**  
TOKYO SEIMITSU

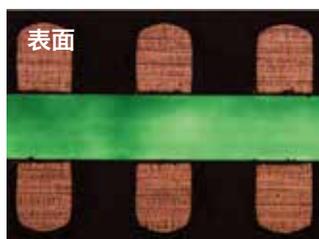


封装材料切割用树脂刀片。  
实现了切割质量和耐磨损，长寿命的并存。



- QFN、DFN 等引线框架封装材料切割用树脂刀片系列
- 追求高速切割、长寿命、稳定的切割品质, 实现产品系列多样化

■加工例 树脂刀片 PG 系列



■ QFN 切割  
 $n = 20,000 \text{ min}^{-1}$   
 $f = 70 \text{ mm/sec}$

■ 高速切割条件下,  
成功控制毛刺的发生。



### 规格和表示方法

**1A8**

形状

**SDC**

颗粒种类

**230**

目数

**75**

集中度

**PG101**

结合剂

### 颗粒种类

SDC

镀膜

### 生产范围

目数

# 170

# 200

# 230

# 270

# 325

### 集中度

50, 75, 100

### 结合剂

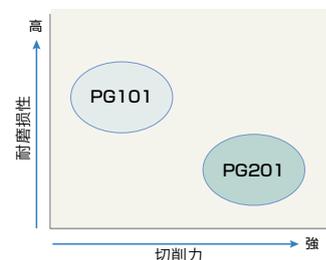
PG101

长寿命

PG201

高品质

※有关新型结合剂PG102、PG202的问题，请另行咨询。



### 尺寸和表示方法

**58D**

**0.2T**

**40H**

外径

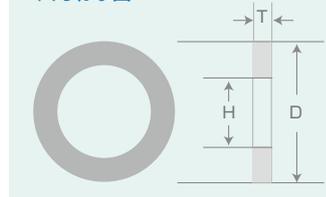
刃厚

内径

### 尺寸规格

外径(mm)		刃厚(mm)		内径(mm)
生产范围	公差	生产范围	公差	生产范围
50~62	+0.1 -0	0.17≤T≤0.35 0.35<T≤0.4	±0.01 ±0.02	40

尺寸标示图



### 生产范围

目数	厚度(mm)				
	0.17≤T ≤0.2	0.2<T ≤0.25	0.25<T ≤0.3	0.3<T ≤0.35	0.35<T ≤0.4
				●	●
				●	●
			●	●	
		●	●	●	
		●	●		

如有上述生产范围外的制作，请垂询商谈。

### 订购产品

订购我司产品时，请参考我司产品目录并告知以下详细信息。

- 1) 形状和尺寸 / 详细的刀片形状和精度要求等
- 2) 规格 / 希望我司提供的规格，以及现在贵司正在使用的刀片产品规格等
- 3) 切割的产品和切割的条件 / 使用设备，主轴转速，进刀速度，冷却条件等

### 注意事项

为了安全地使用刀片以及更好地发挥刀片的性能，请仔细阅读规格书及其他相关的产品信息。

- ※目录有可能未经通知而作修改
- ※该目录并非用于产品质量保证

株式会社東京精密

東精精密设备(上海)有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路1077号凌阳大厦2101C室  
邮编: 201203 TEL / +86-21-3887-0801 FAX / +86-21-3887-0805 <http://www.accretech.com.cn>

株式会社東京精密 東京営業所(代表) 〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2(東京精密八王子工場内)  
TEL / +81-42-631-5211 FAX / +81-42-631-5234 <https://www.accretech.jp>